



8. Symposium Connectors

Elektrische und optische Verbindungstechnik

Vorträge: 23. - 24. März 2021

Tutorial am 22. März 2021



Tagung / Tutorial

Die VDE/VDI Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM) in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und dem VDI Ostwestfalen-Lippe Bezirksverein e.V. lädt Sie herzlich zur Teilnahme am **8. Symposium Connectors vom 23. bis 24. März 2021** ein. Coronabedingt findet diese Veranstaltung erstmalig als **Onlinekongress** statt. Wir geben Ihnen auch in der virtuellen Konferenzform viel Gelegenheit, Wissen und Ideen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und sich über Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. Eine digitale Plattform für Aussteller ist geplant. Weitere Informationen zur Anmeldung, Ausstellung und Begegnungsmöglichkeiten erhalten Sie in Kürze auf **www.connectors-symposium.com**

Am Vortag (22. März 2021) findet ein **Tutorial** zu dem Thema „**Normung**“ mit dem Vortragenden **Wolfgang Niedziella** (Geschäftsführer in der VDE Gruppe, Präsident Elect der europäischen Normungsorganisation CENELEC) statt.

Inhalte:

- Was ist Normung?
- Normungsgrundsätze
- Regeln der Normungsarbeit
- Erarbeitung einer DIN-Norm
- Erarbeitung einer Europäischen Norm (EN)
- Erarbeiten einer Internationalen Norm (IEC)
- Koordination der Normungsorganisationen
- CE-Kennzeichnung

Eine gesonderte Anmeldung ist erforderlich.

Die Fachtagung Symposium Connectors, die alle zwei Jahre stattfindet, bietet eine Plattform für die Industrie, Institutionen und Hochschulen, auf der die neuesten und wichtigsten Entwicklungen und Erfahrungen im Bereich der elektrischen und optischen Steckverbindungen sowie deren Applikationen mittels hochwertigen wissenschaftlichen Beiträgen erörtert werden.

Ausstellung

Sie möchten als Aussteller aktiv werden? Sie bekommen einen eigenen Showroom, die Ausstellergebühr beträgt 250 €.

Teilnahmegebühr

Ein/erster Teilnehmer je Unternehmen (Vollzahler):	230 € ¹
Frühbücher, bei Anmeldung bis zum 19.02.2021:	180 € ¹
Jeder weitere Teilnehmer eines Unternehmens:	170 € ^{1,2}
Frühbücher, bei Anmeldung bis zum 19.02.2021	120 € ^{1,2}
Tutorial (nur gesondert buchbar)	15 €
Aussteller	250 €

1) Die Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive digitalen Tagungsband (PDF-Datei), zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen. Eine Druckversion des Tagungsbandes kann gegen Aufpreis von 10 € separat erworben werden.

2) Ein Vollzahler eines Unternehmens erforderlich.

Die Erstattung der Tagungsgebühr im Fall der Absage des Teilnehmenden ist nur bis zum 05.03.2021 möglich.

Anmeldung (per E-Mail an: con.sym@th-owl.de)

Name

Vorname

Titel

Institution

E-Mail

Rechnungs-Adresse

☐ Teilnehmer ☐ Aussteller

☐ Ja, ich möchte am Tutorial am 22.03.2021 teilnehmen (15 € Teilnahmegebühr).

☐ Ja, ich möchte das Tagungsband als Druckversion (Aufpreis siehe oben).

☐ Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die TH OWL zur Planung und Durchführung des Symposium Connectors 2021 zu. Die Daten werden nach Beendigung der Durchführung des Symposiums gelöscht.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Tagungsbüro unter
con.sym@th-owl.de

Programm Symposium Connectors 2021

Tutorial 22.03.2021

Normung

- Normungsgrundsätze
- Regeln der Normungsarbeit
- Erarbeitung einer DIN-Norm
- Erarbeitung einer Europäischen Norm (EN)
- Erarbeiten einer Internationalen Norm (IEC)
- Koordination der Normungsorganisationen
- CE-Kennzeichnung

Wolfgang Niedziella

(Geschäftsführer in der VDE Gruppe, Präsident Elect der europäischen Normungsorganisation CENELEC)

23. bis 24. März 2021

Hochbeständige, physikalisch abgeschiedene Kontaktoberfläche auf Silberbasis für die Anwendung in Buchsenkontakten

Felix Greiner¹, Sönke Sachs¹, Helge Schmidt¹,
Marjorie Myers², Michael Leidner¹,
Waldemar Stabroth¹, Frank Ostendorf¹
TE Connectivity, ¹Bensheim, ²Harrisburg, USA

Elektrische und tribologische Eigenschaften von Silber-Dispersionsschichten für die Anwendung in Steckverbindungen

Marcella Oberst¹, Toni Israel¹, Stephan Schlegel¹,
Ann-Kathrin Egetenmeyer², Heidi Willing²

1) Technische Universität Dresden
2) Forschungsinstitut Edelmetalle und Metallchemie, Schwäbisch Gmünd

Optimierte Zinnbeschichtung für erhöhte Anwendungstemperaturen

Benjamin Cappi
Aurubis Stolberg, Stolberg

Ausstellung und Pause

Keynote

Aktuelle Herausforderungen der Elektromobilität
Ralf Petri, VDE

Ausstellung und Pause

DLIP Laserstrukturierung von Steckverbindern zur Reduzierung von Steckkräften oder dem elektrischen Kontaktwiderstand

Leander Reinert¹, Dominik Britz, Nikolaus Wanke,
Andrés Lasagni, Frank Mücklich
1) SurFunction, Saarbrücken

Untersuchung von Steckverbindungen bei Strombelastung im Milli- bis Mikrosekunden-Bereich

Toni Israel, Ragnar Müller, Stephan Schlegel
Technische Universität Dresden,
Institut für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik
Helge Schmidt, Michael Ludwig
TE Connectivity, Bensheim

Untersuchung der Korrelation zwischen Verschleißenergie und Verschleißvolumen an Steckverbindern mit Silberbeschichtung

Dirk Hilmert, Haomiao Yuan, Jian Song
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Ausstellung und Pause

Analyse von automobiltauglichen Crimpverbindungen mittels FEM-Simulation

Christian Trebehs
KOSTAL Kontakt Systeme, Lüdenscheid

Optimierung von Steckkontakten mittels gekoppelter Simulation und entsprechender experimenteller Validierung

Tobias Langer¹, Sascha Nolte¹, Abhay Shukla²,
Haomiao Yuan², Roman Probst², Jian Song²
1) Weidmüller, Detmold
2) Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Analytical Model for Ultrasonic Metal Welding Process as Virtual Data Source for Machine Learning

Elisabeth Birgit Schwarz¹, Fabian Bleier¹,
Jean-Pierre Bergmann²
1) Corporate Sector Research and Advance Engineering, Robert Bosch, Renningen.
2) Faculty of Mechanical Engineering, Technische Universität Ilmenau.

Theorie, Grenzen und Anwendungen der thermischen Ersatzschaltbilder für Steckverbinder
Michael Ludwig, Michael Leidner, Helge Schmidt,
Frank Ostendorf
TE Connectivity, Bensheim

ODT-Quantifizierung mittels EDX auf einzelnen Steckern

Martin Bühner
nanoAnalytics, Münster

Oberflächenanalytische Untersuchungen an elektrischen Steckkontakten

Philipp Kolmer¹, Jian Song², Dieter Schramm³
Volkswagen, Group Innovation¹
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Labor für Feinsystemtechnik²
Universität Duisburg-Essen,
Lehrstuhl für Mechatronik³

Fretting behavior of tin plated electrical contacts under various lubrications

Haomiao Yuan, Jian Song
Precision Engineering Laboratory,
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Ausstellung und Pause

Beurteilung von Leiterplatten für Datensteckverbinder durch Messung der Resonanzfrequenzen des Wechselstromwiderstandes

Johannes Werning, Thomas Kaps
Phoenix Contact, Blomberg

Schwingungsarten der Vibrationsprüfung und deren Einfluss auf die Ausfallrate von Steckverbindern

Kevin Krüger, Jian Song
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Untersuchung lokaler Kontaktwiderstände durch Rastersonden-Mikro-Abtastung von Kontaktoberflächen

Sönke Sachs, Helge Schmidt,
TE Connectivity, Bensheim